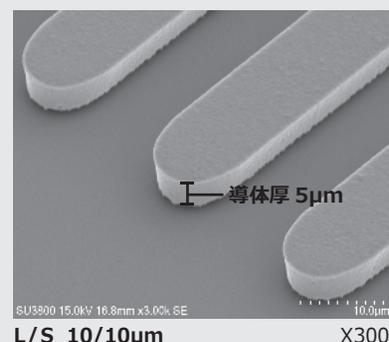
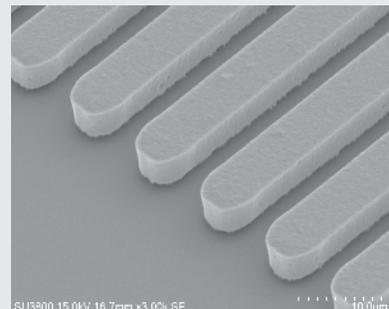
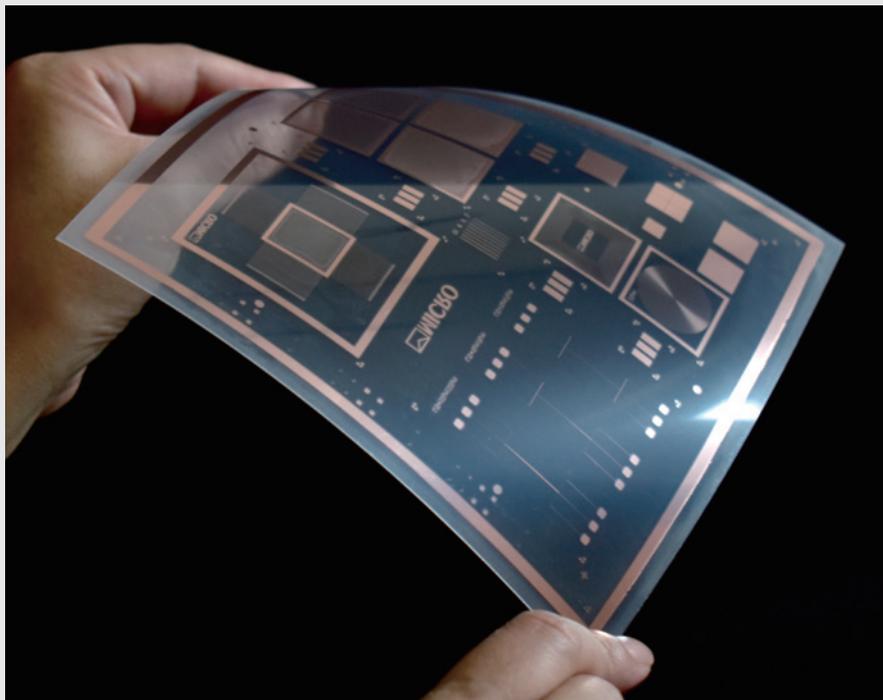


# ガラススリミング配線基板



スリミング加工技術によりガラスを任意の厚みにすることに加え、セミアディティブ銅めっき法を用い、超薄型ガラス基板上に密着強度の高い電極を形成いたします。



## 仕 様

- 板 厚 : 0.05~0.33mm
- ガラスサイズ : 150×150mm
- 材 質 : ソーダガラス ホウケイ酸ガラス
- 電極形成 : (シード層 SP Ti/Cu)+セミアディティブ銅めっき
- 導 体 厚 : 0.2~7µm
- 最小線幅 : L/S 5/5µm
- 密 着 : 1kN 以上

株式会社 ミクロ技術研究所  
MICRO TECHNOLOGY CO., LTD.

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-33-14  
TEL:03-3469-1133 / FAX:03-3469-1557

製品の  
お問合せ先 | T E L: 03-3469-1133  
E-mail: sales@microtc.com

HP : [www.microtc.com](http://www.microtc.com)